

证券代码： 301236

证券简称：软通动力

软通动力信息技术(集团)股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活 动类别	√ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 √ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容）			
参与单位名称 及人员姓名	南证自营 鹏扬基金 银叶投资 中信保诚 正圆投资 凯米基金 中信证券 中电科投资 浙商证券 龙光金控 巨牛投资	青骊投资 银华基金 遵道资产 众安保险 健顺投资 远桥资产 长盛基金 博瑞银泰 国寿养老基金 国盈资本 浩成资产	鹏石投资 中海基金 中邮基金 河清资本 肇万资产 宽渡基金 民生加银 国金基金 浙商保险 国源信达 国证资管	瀚川投资 融通基金 五地投资 方正人寿 歌汝基金 君富投资 观富资产 中信证券自营 创金合信 华西基金 宝宏资产
时间	2025 年 5 月 6 日至 5 月 23 日			
地点	电话会议+现场会议			
上市公司接待 人员姓名	投资者关系总经理 李昕女士 投关团队			

投资者关系活动主要内容介绍	1、随着鸿蒙生态向万物智联迈进，请问公司在技术研发、场景落地及生态体系构建等方面有哪些战略布局？ 基础软硬件的自主可控已成为国家科技战略的核心支撑，公司凭借深厚的技术积累和持续创新能力，坚定推进自主化战略，旗下子公司鸿湖万联引领开源鸿蒙生态建设。 在开源鸿蒙方面，公司专注 OpenHarmony（开源鸿蒙）操作系统研发和服务，具有以 OpenHarmony 为底座研发的自有品牌天鸿操作系统 SwanLinkOS，并首批实现与 HarmonyOS 互联互通。煤矿行业应用上，作为国内某大型 ICT 领导企业首批矿鸿 OSV 伙伴，发布矿鸿 OS 发行版与矿鸿价值场景解决方案，深化布局 20+矿鸿创新场景，中标业内首个千万级矿鸿装备改造项目；电力行业应用上，中标南方电网数据采集装置研究开发项目，完成多款电力设备 OpenHarmony 适配工作，打造能源产业鸿蒙化示范案例；水运行业应用上，参编的《基于 OpenHarmony 的内河船载智能终端技术要求》团体标准正式发布，助力内河航运智能化；教育行业应用上，联合生态伙伴开发教育行业通用板卡，为高职院校提供一体化实训室及人才培养方案。信创行业应用上，发布搭载天鸿操作系统 SwanLinkOS 5 的开源鸿蒙 AI PC，布局鸿蒙 XC 生态信创国产化业务。 在鸿蒙生态方面，围绕 HarmonyOS 全场景多设备高效协同特性，设计研发出跨端迁移、多端协同、近场通信、安全认证等 50 余个组件，助力客户快速完成鸿蒙原生应用的发布与上线，并已支撑文旅、医疗、零售、新闻媒体、酒店住宿、汽车制造等多个行业的上千款应用上架；元服务开发方向上，发布“元服务 020 文旅行业联合解决方案”，打造“青峰峡森林公园”元服务；鸿蒙人才培养上，培养 HarmonyOS 开发者认证通过人数 10000 人次左右，合作院校网络拓展覆盖 140 余所，组织 10 余场高校师资培训，为鸿蒙生态领域储备专业人才；鸿蒙智联方向上，软通动力鸿蒙智联全栈式解决
----------------------	---

方案已与 500+生态品牌伙伴合作，对接 1200+生态产品，获得 670+鸿蒙智联认证证书，已覆盖智能家居、智慧出行、办公教育、影音娱乐、运动健康、母婴等多个场景。

2、请问近期公司有新产品或技术分享吗？

4月29日，公司围绕智能、自主、绿色三大领域发布多个创新产品：智能汽车 AI 操作系统天行 OS、天慧·智园数智空间平台 3.0、天元智算服务平台 2.0 以及软通华方首款麒麟台式机&笔记本、智通国际恒悦品牌 AI 工作站&笔记本&台式机新品，进一步完善了公司全栈智能化产品与服务布局。

天行 OS 作为面向智能汽车的 AI 操作系统，支持多模态与智能体交互，从视听触觉等多维度实现个性化交互，为行业提供高效、灵活、安全的系统级解决方案；天慧·智园数智空间平台 3.0 以 AI 算法与数据智能为核心引擎，深度融合国产化技术底座与 AI 大模型能力，依托天璇 MaaS 和天枢 iSSMeta 数字孪生仿真平台，打造覆盖产城园区、农业园区、数智校园、数智医院及算力中心场景的全生命周期智能化解决方案；天元智算服务平台是集算力融合、算力感知、算力运营、算力管理一体化的 GPU 算力资源共享调度和服务平台，全新发布的 2.0 版本构建起涵盖 IDC 裸金属、自持算力、投资算力、大模型即服务、弹性服务等在内的多元服务体系，并为响应客户私有化场景推出 CDC 专属部署模式，实现客户场景转化能力输出；软通华方麒麟芯台式机和笔记本新品首发，天曜系列新品台式机和超锐 T40 系列笔记本，搭载华为麒麟 9000C 芯片，并在性能、架构设计、生产力及安全等多维度发力；智通国际发布"恒悦"商用终端系列多种产品，包括 AI 工作站、商用笔记本及台式机产品，为企业提供全面、高效的数字化办公解决方案。

3、人工智能技术飞速迭代，请介绍下公司在人工智能领域的布局及技术、产品等情况？

公司以全栈的人工智能技术、产品和服务，助力行业智能化转型。近期，公司携手伙伴发布“昇腾 DeepSeek 专业服务解决方案”、“智慧高校校园联合解决方案”、“CSI 通感一体解决方案”、“昇腾智能医疗诊断平台”、“运营商 ToB 云运营解决方案”、“天慧智园解决方案”六大联合解决方案。

其中，1) 昇腾 DeepSeek 专业服务解决方案，通过场景化服务组合和全流程 ModelMate 工具链，为客户提供从环境部署到模型调优的全链条技术支持，助力企业 AI 应用快速上线；2) 智慧高校校园联合解决方案，通过校园 AI 助手、Wi-Fi 7 通感一体等创新技术，助力高校打造安全、高效、绿色的智慧化校园生态；3) CSI 通感一体解决方案，基于华为 Wi-Fi 7 通感一体技术，联动多维感知打造绿色节能、会议管理、空间管理等智慧园区解决方案，助力企业实现园区的高效智能化应用；4) 运营商 ToB 云运营联合解决方案，基于华为云 Stack 云技术架构和其在混合云场景下灵活部署、高效适配、弹性扩展等优势，深度融合公司自主研发的 CBP (Cloud Business Platform) 平台，构建“云资源+运营服务+生态协同”的一体化解决方案，助力运营商降低云业务门槛、提升规模化交付效率；5) 昇腾智能医疗诊断平台，基于昇腾 AI 基础软硬件及辅助影像诊断算法，提升人工常规诊断效率和患者就医体验；6) 天慧智园解决方案，通过接入 DeepSeek 模型能力对天慧·智园 (iSS-Park) 空间智能平台进行重构，是公司自主研发的具有安全可靠以及标准化、模块化特点的全新解决方案。面向产城园区、制造园区、农业园区、数智校园、算力中心园区等场景提供从弱电子系统建设到应用软件系统建设的全生命周期业务。

此外，近日公司人工智能工程研究院在北京城市副中心揭牌，研究院将聚焦数据工程、模型工程、应用工程三大核心领域，打造

企业级 AI 智能体平台，推出 DeepSeek 大模型一体机全系列产品及服务，为金融、制造等行业提供高效安全的全栈一体机解决方案。

4、公司推出的自主品牌软通华方品牌定位是怎样的，有产品落地了吗？

2024 年 1 月，公司完成同方股份计算机相关业务整合，围绕国产化算力底座，推进软硬协同，打造全栈智能化产品和服务。公司在已有的清华同方和机械革命品牌基础上，推出北京信创整机品牌——软通华方，并与北京城市副中心共建京津冀信创小镇。

自软通华方新品牌发布以来，公司依托京津冀协同发展国家战略，全力推进智能制造基地建设，完成了从厂房改造、产线搭建与调试到智能产线贯通、正式投产的全周期建设。近期，软通华方京牌京产首台服务器产品正式下线，以此次产品下线为起点，公司将以“三个坚持”深化布局：坚持前沿技术投入、坚持场景驱动创新、坚持生态协同共建，携手北京千余家生态伙伴打造信创产业集群。

5、介绍下公司 24 年和 25 年一季度的业绩情况？

2024 年，外部环境复杂多变，公司紧跟行业和市场发展趋势，践行智能化、自主化、绿色化和国际化的“四化”发展战略，坚持软硬一体协同发展，开展软件与数字技术服务、计算产品与智能电子以及数字能源与智算服务三大业务，拓展具身智能机器人新赛道，打造全栈智能化产品与服务，形成智能制造、ICT 软硬基础能力和生产力智能化产品全产业链闭环，实现从国内市场的创新布局到海外市场的全面拓展。

2024 年，公司软硬一体战略驱动业务规模大幅增长，实现营业收入 313.16 亿元，同比提升 78.13%，其中，软件与数字技术服务业务营业收入 181.21 亿元，同比增长 5.0%；计算产品与智能电子业务营业收入 129.20 亿元；数字能源与智算服务业务营业收入

	2.59 亿元。2024 年，公司归母净利润 1.80 亿元，2024 年度拟进行现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例 52.83%，经营活动产生的现金流量净额 7.41 亿元。 2025 年一季度，公司继续践行“四化”发展战略，营收稳健增长，实现营业收入 70.11 亿元，同比增长 28.65%，归母净利润 -1.97 亿元，较去年同期增长 28.76%。 6、请简单介绍下公司本次再融资的相关情况？ 公司本次拟向特定对象发行不超过 285,882,353 股（含本数），募资总额不超过 33.78 亿（含本数），募集资金将用于京津冀软通信创智造基地项目、AIPC 智能制造基地项目、软通动力怀来智算中心（一期）建设项目、计算机生产车间智能升级技术改造项目等 4 个项目，是公司顺应信创产业发展趋势、数据中国战略及智能制造等趋势而做出的重要布局，有利于进一步提升公司在信创、AIPC、智能算力、人工智能等领域的服务质量和竞争力。 通过募投项目的实施，公司将进一步强化在信创产业领域“软硬一体”全栈业务布局优势，并通过建设 AIPC 智能制造基地提高生产规模和生产智能化水平，并将提供更强的集训练与推理的算力能力，为公司的智算业务发展提供有力支撑。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 5 月 6 日至 5 月 23 日